



平成24年2月2日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 S U M C O
代 表 者 名 取 締 役 社 長 田 口 洋 一
(コード：3436 東証第一部)
問 合 せ 先 広 報 ・ I R 室 長 澁 谷 博 史
(TEL. 03-5444-3915)

優先株式の引受け要請に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、住友金属工業株式会社、三菱マテリアル株式会社等に対し、総額450億円の優先株式の引受けの要請を行なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

当社グループは、需要低迷期においても収益を確保できる強固な収益基盤を確立するため、本日、「事業再生計画」を公表いたしました。その骨子は、下記の通りであります。

- イ) ソーラー用シリコンウェーハ事業からの撤退
- ロ) 半導体用シリコンウェーハ事業の生産拠点の再編と集約
- ハ) 生産体制再構築に伴う要員体制の見直し

「事業再生計画」の実行にともない発生する費用、約582億円を事業構造改善費用として、特別損失に計上する予定です。また、個別においては、「事業再生計画」に伴う費用として約348億円を特別損失に計上するとともに、当社が保有するSUMCO TECHXIV株式会社等の連結子会社株式の実質価額が低下したため、減損処理を実施し、約454億円を関係会社株式評価損として特別損失に計上する予定です。

また、不透明な市場環境に鑑み、繰延税金資産273億円を取り崩すことから、自己資本が大幅に減少する見込みであります。

かかる財務状況を踏まえ、当社といたしましては、大株主である住友金属工業株式会社殿、三菱マテリアル株式会社殿に対し各150億円を含め最大450億円の優先株式を発行することで、財務体質の安定化を図り、取引先からの信用の維持向上につなげることが、当社の長期的な株主価値維持・向上に資すると判断いたし、今般優先株式の引受けの要請を行うに至りました。今後も当社は、「事業再生計画」の遂行による収益力の強化と、今次の資本増強による経営基盤安定化により、株主の皆様ならびに取引先の皆様のご期待に添えてまいりたいと考えております。

当社は、今後、住友金属工業株式会社殿、三菱マテリアル株式会社殿等との間で優先株式の内容及び条件等を協議してまいります。当社としては、優先株式の設計に関し、既存株主の皆様への希薄化に対する懸念に配慮する方針で協議を進めてまいります。なお、優先株式の発行総額、内容及び条件等の詳細につきましては決定次第速やかにお知らせいたします。

本資料は一般の株主及び投資家に対する情報提供を目的に作成されたものであり、いかなる法域においても、当社が発行する証券の勧誘を構成するものではありません。

本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、半導体市況、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。

2. 優先株式の発行概要

- | | |
|----------------|--|
| (1) 増資方法 | 第三者割当増資による |
| (2) 株式の種類 | 優先株式 |
| (3) 発行価額の総額 | 最大 450 億円 |
| (4) 割当予定先 | 住友金属工業株式会社
三菱マテリアル株式会社
その他 |
| (5) 今後の日程 (予定) | 2012 年 3 月上旬: 本優先株式発行に係る取締役会決議、最終契約締結
臨時報告書提出 (注)
2012 年 4 月下旬: 株主総会開催日
2012 年 5 月上旬: 本優先株式発行日 (第 13 回定時株主総会の承認可決後) |

(注) 本優先株式は、企業内容等開示ガイドラインCIII(1)④に定める、「取得請求権が付されている種類株券が第三者割当により発行される場合であって、割当予定先又は発行体等の自由な裁量等により、短期間に有価証券届出書の発行が相当程度見込まれるもの」に該当しない内容とする予定であり、金融商品取引法に従う有価証券届出書の提出は行なわない予定です。

※上記概要については、今後の協議の結果、変更となる可能性があります

3. 割当予定先の概要

① 住友金属工業株式会社

(2011 年 9 月末現在)

(1) 名称	住友金属工業株式会社	
(2) 所在地	大阪市中央区北浜四丁目 5 番 33 号	
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 友野 宏	
(4) 事業内容	1. 製鉄事業 (鉄鋼の製造・販売) 2. 新素材 3. 土木・建築・プラント 4. 電子部品 5. 電力供給 6. システムソリューション	
(5) 資本金	262,072 百万円	
(6) 設立年月日	1949 年 7 月 1 日	
(7) 発行済株式総数	4,805,974,238 株	
(8) 決算期	3 月 31 日	
(9) 従業員数	22,597 人 (連結:2011 年 3 月末現在)	
(10) 主要取引先	住友商事株式会社 住金物産株式会社	
(11) 主要取引銀行	株式会社三井住友銀行 住友信託銀行株式会社	
(12) 大株主及び持株比率	住友商事株式会社	9.54%
	新日本製鐵株式会社	9.40%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	4.01%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	2.91%
	株式会社神戸製鋼所	2.34%

本資料は一般の株主及び投資家に対する情報提供を目的に作成されたものであり、いかなる法域においても、当社が発行する証券の勧誘を構成するものではありません。

本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、半導体市況、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口)	1.88%
日本生命保険相互会社	1.85%
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT -TREATY CLIENTS (常任代理人 香港上海銀行東京支店)	1.52%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)	1.23%
NT RE GOVT OF SPORE INVTICORP P.LTD (常任代理人 香港上海銀行東京支店)	1.19%

(13) 当社との関係

資本関係	割当予定先は当社の普通株式を 71,700,000 株保有しております。
人的関係	当社取締役高橋 健二は割当予定先の常務執行役員であり、当社監査役吉田喜太郎は割当予定先の常任監査役であります。
取引関係	当社は、当該会社の関連会社である株式会社大阪チタニウムテクノロジーからシリコンウェーハの主要原料である多結晶シリコンを購入しております。また、当該会社の子会社である株式会社住友金属ファインテックから半導体用シリコンウェーハ製造工程において使用される設備の一部を購入しております。
関連当事者への該当状況	当社は割当予定先の持分法適用関連会社であります。

(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位：百万円。特記しているものを除く。)

決 算 期	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期
連 結 純 資 産	904,371	879,209	818,080
連 結 総 資 産	2,452,535	2,403,670	2,440,761
1株当たり連結純資産 (円)	184.92	178.87	165.41
連 結 売 上 高	1,844,422	1,285,845	1,402,454
連 結 営 業 利 益	226,052	▲928	56,301
連 結 経 常 利 益	225,736	▲36,634	34,049
連 結 当 期 純 利 益	97,327	▲49,772	▲7,144
1株当たり連結当期純利益 (円)	20.98	▲10.74	▲1.54
1株当たり配当金 (円)	10.0	5.0	3.5

② 三菱マテリアル株式会社

(2011年9月末現在)

(1) 名称	三菱マテリアル株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区大手町一丁目3番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 矢尾 宏
(4) 事業内容	セメント・セメント二次製品等の製造・販売、銅・金・銀等の製錬・加工・販売、超硬製品・高機能製品等の製造・販売、機能材料・電子デバイス製品・多結晶シリコン等の製造・販売、飲料用アルミ缶・アルミ圧延品等の製造・販売
(5) 資本金	119,457 百万円
(6) 設立年月日	1950年4月1日
(7) 発行済株式総数	1,314,895,351 株

本資料は一般の株主及び投資家に対する情報提供を目的に作成されたものであり、いかなる法域においても、当社が発行する証券の勧誘を構成するものではありません。
本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、半導体市況、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。

(8) 決算期	3月31日		
(9) 従業員数	21,762人(連結:2011年3月末現在)		
(10) 主要取引先	セメント、銅、金属加工品、電子部品、電子材料、アルミ等を広く国内外の需要家に販売		
(11) 主要取引銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社		
(12) 大株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)		5.87%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)		5.01%
	明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)		2.36%
	SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT -TREATY CLIENTS (常任代理人 香港上海銀行東京支店)		2.06%
	株式会社三菱東京UFJ銀行		1.87%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)		1.68%
	日本生命保険相互会社		1.50%
	三菱重工業株式会社		1.46%
	三菱UFJ信託銀行株式会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)		1.37%
	三菱地所株式会社		1.32%
(13) 当社との関係			
資本関係	割当予定先は当社の普通株式を71,700,000株保有しております。		
人的関係	当社取締役橋本 真幸は割当予定先の代表取締役副社長であり、当社監査役山ノ辺 敬介は割当予定先の代表取締役常務取締役であります。		
取引関係	当社は、当該会社からシリコンウェーハの主要原料である多結晶シリコンを購入しております。また、当該会社の子会社である三菱マテリアルテクノ株式会社から半導体用シリコンウェーハ製造工程において使用される設備の一部を購入しております。		
関連当事者への該当状況	当社は割当予定先の持分法適用関連会社であります。		
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態(単位:百万円。特記しているものを除く。)			
決 算 期	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期
連 結 純 資 産	421,934	399,095	402,868
連 結 総 資 産	1,732,003	1,826,420	1,837,405
1株当たり連結純資産(円)	287.44	259.93	262.38
連 結 売 上 高	1,424,114	1,119,448	1,333,992
連 結 営 業 利 益	35,134	12,680	57,290
連 結 経 常 利 益	40,046	▲9,541	56,425
連 結 当 期 純 利 益	6,106	▲66,555	14,274
1株当たり連結当期純利益(円)	4.81	▲52.34	10.88
1株当たり配当金(円)	4.00	0.00	2.00

住友金属工業株式会社/三菱マテリアル株式会社以外の割当予定先については、確定し次第概要をお知らせいたします。

以上

本資料は一般の株主及び投資家に対する情報提供を目的に作成されたものであり、いかなる法域においても、当社が発行する証券の勧誘を構成するものではありません。
本資料に記載された予測、予想、見込みその他の将来情報は、本日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであり、実際の業績等は、国内外の経済情勢、半導体市況、為替動向その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。